



Memoria RAM DDR4 / 8 GB / 3200 MHz / CL19 / UDIMM 288 Pines / Intel XMP 2.0 / Perfil Bajo 31.25 mm (1.23 in)

SKU: HS-C408-U32D2/8G Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Memorias RAM

\$1,463.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de memoria DDR4 de 8 GB diseñado para estaciones de trabajo y equipos de gaming que requieren ancho de banda sostenido sin cuellos de botella. Opera a 3200 MHz con latencia CL19, ofreciendo tiempos de respuesta optimizados para cargas pesadas, multitarea intensiva y renderizado de video. Incorpora disipador Armor de aluminio que mantiene la estabilidad térmica bajo demanda continua. Compatible con perfiles Intel XMP 2.0 para configuración automática de frecuencia y latencia desde BIOS. Su perfil bajo de 31.25 mm (1.23 in) garantiza compatibilidad física con sistemas de refrigeración de torre de gran tamaño. Formato UDIMM de 288 pines, compatible con plataformas Intel y AMD actuales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 8 GB<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: DDR4<li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia: 3200 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Latencia CAS: CL19<li style='margin-bottom: 8px;'>Formato: UDIMM de 288 pines<li style='margin-bottom: 8px;'>Perfil de overclocking: Intel XMP 2.0<li style='margin-bottom: 8px;'>Disipador: Armor de aluminio<li style='margin-bottom: 8px;'>Altura del módulo: 31.25 mm (1.23 in)<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura máxima de operación: 85 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: Plataformas Intel y AMD recientes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia: 3200 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Latencia CAS: CL19<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología de overclocking: Intel XMP 2.0<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura máxima: 85 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Formato: UDIMM de 288 pines<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 8 GB<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: DDR4<li style='margin-bottom: 6px;'>Altura del módulo: 31.25 mm (1.23 in)<li style='margin-bottom: 6px;'>Disipador: Armor de aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Módulo de memoria DDR4 8 GB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Disipador Armor de aluminio para estabilidad térmica continua en cargas prolongadas
Característica 2	Intel XMP 2.0 para overclocking automático desde BIOS con un solo clic
Característica 3	Latencia CL19 para respuesta inmediata en gaming competitivo y renderizado
Característica 4	Perfil bajo de 31.25 mm (1.23 in) compatible con coolers de torre de gran tamaño
Característica 5	Compatibilidad verificada con plataformas Intel y AMD recientes
Característica 6	UDIMM de 288 pines estándar para instalación plug-and-play en builds actuales